



Deutsches IMAPS-Seminar 2007 in Ilmenau

Das Frühjahrsseminar 2007 der *IMAPS Deutschland* fand in diesem Jahr erstmalig an der *TU Ilmenau* statt. Dies war durch die nunmehr erfolgte Autobahnanbindung in Richtung Süden und die Fertigstellung des *Humboldtbaus* auf dem Campus der TU möglich geworden. Dieses Gebäude ermöglicht außer Lehrveranstaltungen auch Konferenzen mit angeschlossener Ausstellung, da dafür im Foyer genügend Fläche zur Verfügung steht.

Das Motto des Frühjahrsseminars 2007 lautete *FlipChip – die Alternative zum Drahtbonden?* und war offensichtlich richtig gewählt, denn es konnten 14 Aussteller und ca. 90 Besucher gezählt werden. Ilmenau zeigte sich auch von seiner besten Seite und die verschneiten Berge boten vom Campus aus einen recht attraktiven Anblick.



Auch diesmal gab es in der Vormittagssession 4 Podiumsvorträge. Dabei beleuchtete *J. Kloeser, Aemtec*, Berlin, das Thema aus Anwendersicht, *M. Schneider-Ramelow, IZM*, Berlin, stellte das nach wie vor vorhandene Potenzial des Drahtbondens in den Mittelpunkt seines Vortrags, während *K. Wolter, TU Dresden*, gegenwärtige und zukünftige Anforderungen an die Technologie darstellte. Abgerundet wurde diese Reihe mit einem Beitrag von *H. Hesse, Hesse & Knips*, Paderborn, zu neuen Entwicklungen der Online-Bondqualitätsprüfung.

Die nachfolgende erste Kaffeepause bot Gelegenheit, die Ausstellung zu besuchen und mit den anderen Besuchern ins Gespräch zu kommen. Anschließend moderierte *R. Aschenbrenner* die Podiumsdiskussion zum



Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion (von links): T. Müller, M. Schneider-Ramelow, J. Kloeser, K. Wolter, H. Hesse

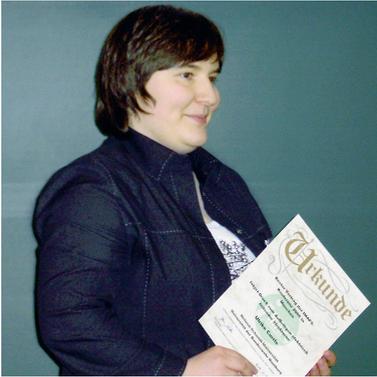
Seminarthema, die von den Vortragenden der Podiumssession sowie *T. Müller, Heraeus*, Hanau, bestritten wurde.

Erwartungsgemäß konnte die Frage *FlipChip – die Alternative zum Drahtbonden?* auch von dieser kompetenten Runde nicht abschließend beantwortet werden. Beide Technologien bieten noch große Spielräume und auch für die schon so oft totgesagte Drahtbondtechnik zeigen die Umsatzzahlen für Material und Ausrüstungen zum jetzigen Zeitpunkt steil nach oben.

Der Nachmittag war den insgesamt 9 Fachvorträgen vorbehalten. Dabei war das Themenspektrum weit gespannt und reichte von Hochfrequenzanwendungen im Gigahertzbereich über die Medizintechnik bis zu Bondproblemen bei Hochstromanwendungen.

Während der Veranstaltung überreichte der Vorsitzende von IMAPS Deutschland, *J. Müller*, der Preisträgerin des *Best Paper Awards* der Herbsttagung 2006, *U. Currel, Helmut Schmidt Universität*, Hamburg, die Urkunde.

Der reibungslose Ablauf des Frühjahrsseminars wurde von Mitarbeitern der Nachwuchsforscherguppe *Funktionalisierte Peripherik* sowie des Fachgebiets *Elektroniktechnologie* der *TU Ilmenau* sichergestellt. Einen erheblichen Beitrag leisteten auch die Mitarbeiter des Bereichs *Kongressorganisation* der *TU Ilmenau*. Allen Beteiligten sei hiermit herzlich gedankt.



Die Preisträgerin des Best Paper Award der Herbsttagung 2006, U. Currie

Organische Funktionssysteme für die Mikrosystemtechnik

Das BMBF fördert im Rahmenprogramm *Mikrosysteme* die Forschung und Entwicklung von organischen bzw. organisch/anorganischen Funktionssystemen und deren Integration in komplexe Mikrosysteme. Damit soll das große Potenzial an neuen Kombinationsmöglichkeiten und Funktionalitäten genutzt werden. Einsendeschluss für Ideenskizzen ist der **20. April 2007**.

Organische Funktionssysteme bieten erhebliche Potenziale aus den vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten einzelner Komponenten in komplexen Mikrosystemen, wie zum Beispiel von Sensorik oder Aktorik mit Fluidik und Logik, beispielsweise ein Sensorchip, der aus mikrofluidischen Strukturen und Aktoren oder geeigneten Sensoren und einer Auswerte- oder Kommunikations-elektronik besteht. Des Weiteren erlauben organische Systeme preiswerte hochdurchsatzfähige Strukturierungs- und Produktionstechnologien wie zum Beispiel das Drucken oder andere Rolle-zu-Rolle-Verfahren. Die Verwendung organischer Funktionsmaterialien eröffnet im Vergleich zu herkömmlichen Halbleitertechnologien eine Vielzahl von Vorteilen, die vor allem in der vergleichsweise einfachen Kombinierbarkeit und Integrierbarkeit verschiedener Funktionalitäten, in der freien Formgebung, sowie in der Anwendbarkeit von Technologien mit geringen Herstellungskosten und Tauglichkeit für die Massenproduktion gesehen werden. Gegenstand der Förderung im Rahmen dieser Bekanntmachung ist die Forschung und Entwicklung von organischen bzw. organisch/anorganischen Funktionssystemen und deren Integration in komplexe Mikrosysteme sowie der erforderlichen Herstellungs-, Strukturierungs- und Integrationstechnologien.

www.mstonline.de

Mikrosystemtechnik-Kongress 2007 in Dresden

Vom 15. bis zum 17. Oktober findet in Dresden zum zweiten Mal der *Mikrosystemtechnik-Kongress* statt – die zentrale Mikrosystemtechnik-Veranstaltung in Deutschland. Schon der erste Kongress 2005 in Freiburg war mit 800 Teilnehmern und 50 Ausstellern sehr erfolgreich. Der kommende *Mikrosystemtechnik-Kongress 2007* ist wie sein Vorgänger eine gemeinsame Veranstaltung des *Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)* und des *VDE* und wird von der *VDE/VDI-Gesellschaft Mikroelektronik, Mikro- und Feinwerktechnik (GMM)* und der *VDI/VDE-IT* organisiert.

www.mikrosystemtechnik-kongress.de

Noch zu haben: Proceedings

Die Proceedings des *Deutschen IMAPS-Seminars 2006*, das am 9. Februar 2006 in Göppingen zum Thema *Muss jeder Sensor smart sein?* stattfand, können auf CD zum Preis von



€ 55,-

und als Papiausdruck zum Preis von



€ 110,-

erworben werden.

Auch die Proceedings der *Herbsttagung 2006*, die am 10. und 11. Oktober 2006 in München durchgeführt wurde, sind jetzt als CD zum Preis von



€ 55,-

erhältlich.

Richten Sie bitte Ihre Bestellungen an:

Dipl.-Oec. Hans-Ulrich Knipps, c/o Hesse & Knipps GmbH, Vattmannstraße 6, D-33100 Paderborn, Fax: 05251/1560-97, hans-ulrich.knipps@imaps.de

Bitte beachten Sie, dass der angegebene Preis gemäß § 4 Nr. 22 UstG umsatzsteuerfrei ist und die verfügbare Anzahl begrenzt ist.

Internet-Auftritt von IMAPS Deutschland

Sie finden die Webseiten von IMAPS Deutschland im Internet unter

<http://www.imaps.de>

Hier erhalten Sie aktuelle Informationen über Veranstaltungen und Ansprechpartner von *IMAPS Deutschland e.V.* Darüber hinaus können Sie dort auch Ihre Mitgliedschaft beantragen. Über Kritik und Anregungen, aber auch inhaltlichen Input würde sich der Vorstand sehr freuen.

Die internationalen Seiten von IMAPS erreichen Sie unter

<http://www.imaps.org>

oder für Europa:

<http://www.imapseurope.org>

Veranstaltungskalender

Ort	Zeitraum	Name	Veranstalter
Denver, Colorado	23./26.4.2007	IMAPS / ACerS 3. Konferenz für CICMT (Ceramic Interconnect and Ceramic Microsystems Technology)	IMAPS Nordamerika / Amerikanische Keramische Gesellschaft ACerS
Oulu, Finnland	17./20.6.2007	EMPC 2007 – 16 th European Microelectronics and Packaging Conference & Exhibition	IMAPS Nordic / Europa
München	8./9.10.2007	IMAPS Konferenz 2007	iMAPS D
München	10./11.10.2007	Advanced Packaging Conference	SEMI, IMAPS Europe
Dresden	15./17.10.2007	Mikrosystemtechnik-Kongress 2007	BMBF, VDE

Kontakte und Adressen des IMAPS-Vorstandes

Dr.-Ing. Jens Müller
1. Vorsitzender
c/o ZiK MacroNano
Applikationszentrum Ilmenau
Gustav-Kirchhoff-Str. 5
98693 Ilmenau
Fon: 03677/69-3381
Fax: 03677/69-3379
e-mail: jens.mueller@imaps.de

Dr.-Ing. Gisela Dittmar
2. Vorsitzende
c/o Ingenieurbüro Elektroniktechnologie
Egerlandstraße 88
D-73431 Aalen
Fon: 07361/931129
Fax: 07361/943004
e-mail: gisela.dittmar@imaps.de

Dipl.-Oec. Hans-Ulrich Knipps
Schatzmeister
c/o Hesse & Knipps GmbH
Vattmannstraße 6
D-33100 Paderborn
Fon: 05251/1560-14
Fax: 05251/1560-97
e-mail: hans-ulrich.knipps@imaps.de

Prof. Dr.-Ing. Matthias Fischer
Schriftführer
c/o FH Schmalkalden
FB Elektrotechnik

D-98574 Schmalkalden
Fon: 03683/688-5116
Fax: 03683/688-5499
e-mail: matthias.fischer@imaps.de

Dipl.-Phys. Rolf Aschenbrenner
Öffentlichkeitsarbeit
c/o Fraunhofer Institut Zuverlässigkeit und Mikrointegration
Chip Interconnection Technologies
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
Fon: 030/46403-164
Fax: 030/46403-161
e-mail: rolf.aschenbrenner@imaps.de

Dipl.-Ing. Thomas Bartnitzek
Öffentlichkeitsarbeit
c/o VIA electronic GmbH
Robert-Friese Straße 3
D-07629 Hermsdorf
Fon: 036601/81-529
Fax: 036601/81-530
e-mail: thomas.bartnitzek@imaps.de

Dipl.-Ing. Paradiso Coskina
Öffentlichkeitsarbeit
c/o VDI/VDE Innovation + Technik GmbH
Steinplatz 1
D-10623 Berlin
Fon: 030/310078-242
Fax: 030/310078-256
e-mail: paradiso.coskina@imaps.de

Dr.-Ing. Karl-Heinz Drüe
Öffentlichkeitsarbeit
c/o TU Ilmenau
Fakultät EI
FG Mikroperipherik
Pf 100565
D-98684 Ilmenau
Fon: 03677/69-3429
Fax: 03677/69-3350
e-mail: karl-heinz.drue@imaps.de

Ernst Eggelaar
Öffentlichkeitsarbeit
c/o Microtronic Microelectronic Vertriebs GmbH
Klein Grötzing
D-84494 Neumarkt-St. Veit
Fon: 08722/9620-0
Fax: 08722/9620-30
e-mail: ernst.eggelaar@imaps.de

Prof. Dr.-Ing. Heinz Osterwinter
Öffentlichkeitsarbeit
c/o FHTE Standort Göppingen
Robert-Bosch-Str. 1
D-73037 Göppingen
Fon: 07161/679-157
Fax: 07161/679-233
e-mail: heinz.osterwinter@imaps.de

Dr. Martin Oppermann
Öffentlichkeitsarbeit
EADS Deutschland GmbH
Microwave Factory / Defence Electronics
Woerthstr. 85
D-89077 Ulm
Fon: 0731/392-3879
Fax: 0731/392-3362
e-mail: martin.oppermann@imaps.de

Korrosionsschutz in der Elektronik

Von J. L. Jostan, W. Mussinger und A. F. Bogenschütz. Erste Auflage 1986. 224 Seiten mit 133 Abbildungen, 34 Tabellen mit Prüfvorschriften u. Normenteil im Anhang. ISBN 3-87480-028-8. Preis € 58,- inkl. MwSt., zuzüglich Porto

Fragen des Korrosionsschutzes spielen auch auf dem elektronischen Sektor eine stetig wachsende Rolle, da durch Korrosionseffekte nicht nur die Eigenschaften und die Funktionstüchtigkeit von Kontakten, gedruckten Schaltungen und anderer Bauteile ungünstig beeinflusst werden, sondern auch die Lebensdauer von Geräten und die Verfügbarkeit und Sicherheit ganzer elektronischer Systeme beeinträchtigt werden können.

Das Buch stellt, nicht zuletzt durch seinen direkten Praxisbezug, eine unentbehrliche Hilfe für alle diejenigen Fachkollegen dar, die es auf dem Elektroniksektor mit Korrosionsschutzproblemen zu tun haben.

Allen Konstrukteuren, Verfahrenstechnikern, Qualitätsprüfern, Kontaktspezialisten und Galvanotechnikern kann es als unverzichtbare Arbeitsgrundlage deshalb wärmstens zur Anschaffung empfohlen werden.

Eugen G. Leuze Verlag KG

Karlstraße 4 · D-88348 Bad Saulgau · Tel. 07581/4801-0 · Fax 07581/4801-10
e-mail: brigitte.brotzer@leuze-verlag.de · Internet: www.leuze-verlag.de